



连接器 > PCB 连接器 > 内存卡连接器 > CompactFlash 连接器



PCB 端接方法: **表面贴装**

端子布局: **直插式**

PCB 安装方向: **直角**

工作温度范围: -55 – 85 °C [ -67 – 185 °F ]

## 产品特性

### 产品类型特性

连接器系统	缆到板
连接器和端子端接到	印刷电路板

### 结构特性

行数	2
位数	50
PCB 安装方向	直角

### 主体特性

主要产品颜色	白色
连接器外形	低

### 接触件特性

端子接触部电镀材料	15 μin
端子接触部电镀材料	金
端子底板材料	镍
PCB 端子端接区域电镀材料	锡
端子基材	黄铜
端子额定电流 (最大值)	.5 A
端子布局	直插式

### 端接特性

PCB 端接方法	表面贴装
----------	------

### 机械附件

--	--

## 连接器安装类型

板安装

## 壳体特性

## 外壳材料

热塑性

## 中心线 (间距)

1.27 mm[.05 in]

## 使用环境

## 工作温度范围

-55 – 85 °C[-67 – 185 °F]

## 操作/应用

## 装配工艺特点

压紧, 真空带

## 电路应用

Signal

## 行业标准

## UL 阻燃性等级

UL 94V-0

## 包装特性

## 封装方法

卷带包装, 卷带包装

## 产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

## 欧盟RoHS指令2011/65/EU

符合

## 欧盟ELV指令2000/53/EC

符合

## 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令

没有超出阈值的受限材料

## 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006

欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2024年1月 (240)  
SVHC候选清单的声明更新至: 2017年7月 (174)  
不含REACH SVHC

## 卤素含量

低卤素 - 每种均质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC

## 焊接工艺能力

回流焊接可达到 260°C

## 产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%（按重量计算），或符合指令2000/53/EC(ELV)附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质(SVHC)的信息是基于欧洲化学品管理局(ECHA)最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

## 客户还购买了



## 文档

### CAD 文件

3D PDF

3D

### 下载查看

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_2-1734451-1\\_E\\_c-2-1734451-1-e.2d\\_dxf.zip](#)

英文版本

### 下载查看

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_2-1734451-1\\_E\\_c-2-1734451-1-e.3d\\_igs.zip](#)

英文版本

### 下载查看

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_2-1734451-1\\_E\\_c-2-1734451-1-e.3d\\_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

### 产品规格

COMPACT FLASH CARD, 1.27mm(.050") PITCH

英文版本



**产品规格**

英文版本